

**ПОВЕРХНОСТНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ ЭНЕРГИИ
И ЭФФЕКТ БЕНЕДИКСА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ**

Стельмах О. Б., Чекурин В. Ф.

В связи с возможным практическим применением эффекта Бенедикса [1] представляют интерес выяснение механизмов его возникновения и вычисление величины ЭДС. Рассматривались механизмы, связанные с диффузией неравновесных термически генерированных носителей [1] и с влиянием градиента температуры на коэффициент объемной термоэдс [2].

Необходимым условием наблюдения эффекта Бенедикса является высокая градиентность температурного поля, поэтому исследования, как правило, проводятся на образцах ограниченных размеров. При этом распределение электронной температуры, а следовательно, и величина возникающей термоэдс существенно зависят от условий теплообмена подсистем полупроводника с внешней средой. Для вычисления этой ЭДС необходимо решить систему уравнений теплопроводности для носителей тока и фононов [3]. Предположим, что боковая поверхность образца, ориентированного вдоль оси x , теплоизолирована. Образец контактирует с тремя термостатами в точках $x = -a_1, 0, a_2$, температуры которых соответственно равны T_0, T_1, T_0 . Для фононной подсистемы примем условия идеального теплового контакта с термостатами. Взаимодействие электронной подсистемы с поверхностью контакта будем учитывать поверхностью релаксацией энергии этой подсистемы, принимая граничные условия в виде

$$\begin{aligned} \frac{dT_{(n)}}{dx} &= \frac{s_1 k_B}{\kappa_{(n)}} (T_{(n)} - T_{(s)}) \quad \text{при } x = -a_1, \\ \frac{dT_{(n)}}{dx} &= -\frac{s_2 k_B}{\kappa_{(n)}} (T_{(n)}^* - T_{(s)}) \quad \text{при } x = a_2. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь $T_{(n)}(x)$ и $T_{(s)}(x)$ — температуры электронной и фононной подсистем; s_1 и s_2 — скорости остывания носителей на поверхностях $x = -a_1$ и $x = a_2$; $\kappa_{(n)}$ — теплопроводность электронной подсистемы; k_B — постоянная Больцмана. При этом, если a_1 намного больше длины остывания k^{-1} и $a_2 \ll a_1$, то в случае слабо легированного образца получим следующее выражение для термоэдс Бенедикса:

$$U_B = \frac{\alpha_{cp} \kappa_{(n)} (\exp k a_2 - 1) \Delta T}{a_2 (k \kappa_{(n)} + k_B s_2) \exp k a_2}. \quad (2)$$

Здесь $k = \sqrt{P(\kappa_{(n)} + \kappa_{(s)}) / (\kappa_{(n)} \kappa_{(s)})}$; $\Delta T = T_1 - T_0$; P — коэффициент теплообмена между подсистемами; $\kappa_{(s)}$ — теплопроводность решетки; α_{cp} — среднее значение коэффициента объемной термоэдс в интервале температур $[T_{(n)}(-a_1), T_{(n)}(a_2)]$. Отсюда следует, что в случаях, когда $k_B s_2 \ll k \kappa_{(n)}$, поверхностная релаксация энергии не оказывает существенного влияния на ЭДС Бенедикса.

Если выполняется также условие $\exp k a_2 \gg 1$, то вместо (2) получим

$$U_B = \frac{\alpha_{cp} \kappa_{(n)} \Delta T}{a_2 (k \kappa_{(n)} + k_B s_2)}. \quad (3)$$

При симметричном нагреве ($a_1 = a_2 = a$) ЭДС Бенедикса зависит от разности скоростей остывания носителей на поверхностях $x = -a_1$ и $x = a_2$. В этом случае для слабо легированного полупроводника имеем

$$U_B = \frac{\alpha_{cp} \kappa_{(n)} k_B (s_2 - s_1) (2 \operatorname{sh} k a - \operatorname{sh} 2 k a) \Delta T}{a [(k^2 \kappa_{(n)} + k_B^2 s_1 s_2) \operatorname{sh} 2 k a + k_B k \kappa_{(n)} (s_1 + s_2) \operatorname{ch} 2 k a]}. \quad (4)$$

Формула (3) довольно хорошо описывает экспериментальные результаты, приведенные в [2]. Действительно, поскольку в условиях проведения эксперимента α_{cp} слабо изменяется с изменением ΔT , то зависимость U_B от ΔT , рассчи-

танская по формуле (3), будет близка к линейной, что наблюдалось в эксперименте. Рассчитанные значения ЭДС Бенедикса при $\Delta T=60$ К составляют ~ 0.8 мВ, соответствующие экспериментальные значения $\sim 3-4$ мВ. При расчете коэффициент P оценивался по формуле $P=3nk_B/(2\tau_e)$, где n — концентрация носителей, τ_e — среднее время релаксации энергии. Полученное значение k составляло $5 \cdot 10^5$ м⁻¹, длина $a_2=110$ мкм, так что условие $exp(ka_2) \gg 1$ выполнялось. Отметим, что для $\Delta T=60$ К в работе [2] получено даже лучшее совпадение между теоретическими и экспериментальными результатами ($U_B \sim 1$ мВ). Для этого авторам пришлось сделать предположение о том, что релаксация энергии носителей определяется их рассеянием на акустических фонах, а импульса — на ионизированных примесях. Однако при меньших значениях ΔT теоретическое значение U_B , полученное в этой работе, заметно меньше экспериментального. Это нетрудно понять, если учесть, что приведенная в [2] теоретическая зависимость U_B от ΔT имеет вид кубической параболы, в то время как экспериментальная зависимость близка к линейной. В нашем случае различие между теоретическими и экспериментальными значениями U_B примерно одинаково во всех точках диапазона изменения ΔT . Так, при $\Delta T=10$ К полученное нами значение $U_B \sim 0.14$ мВ, экспериментальное значение $U_B \sim 2$ мВ.

В заключение отметим, что некоторое расхождение между экспериментальными и теоретическими результатами может быть связано с тем, что принятые в данной модели условия не полностью соответствовали условиям эксперимента. В частности, нагрев образца производился не в одной точке, а по некоторой поверхности. Это могло привести к тому, что длина a_2 в действительности была меньшей.

Л и т е р а т у р а

- [1] Тауц Я. Фото- и термоэлектрические явления в полупроводниках. М., 1962. 256 с.
- [2] Анатычук Л. И., Булат Л. П., Комолов Е. Н. — ФТП, 1982, т. 16, в. 9, с. 1711—1713.
- [3] Басс Ф. Г., Бочков В. С., Гуревич Ю. Г. Электроны и фононы в ограниченных полупроводниках. М., 1984. 288 с.

Институт прикладных проблем
механики и математики АН УССР
Львов

Получено 17.11.1987
Принято к печати 25.03.1988

ФТП, том 22, вып. 9, 1988

СПЕКТРЫ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОНТАКТА I—III—VI₂—ЭЛЕКТРОЛИТ

Константинова Н. Н., Прочухан В. Д., Рудь Ю. В., Таиров М. А.

В последние годы происходит расширение физических исследований фотоЭлектрохимических ячеек на основе тройных полупроводников, что свидетельствует о возможностях их использования в качестве фотопреобразователей солнечной энергии.

Физические свойства кристаллов I—III—VI₂
и электрохимических ячеек на их основе ($T=300$ К)

Кристалл	Структура	Тип проводимости	ρ , Ом·см	$1/ R e$, см ⁻³	E_G , эВ	Область S_u^m , эВ	S_u^m , В/Вт	$\sigma_{\text{эл}}$
CuInTe ₂	Халькоширит	<i>p</i>	0.01	2·10 ¹⁹	0.96, 1.06	1.2	3·5	30
CuInSe ₂				3·10 ¹⁷	1.04	1.2	600	60
CuInS ₂				2·10 ¹⁶	1.53	1.53	5·10 ⁴	65
AgGaTe ₂				6·10 ¹⁵	1.32	1.6	200	20
AgInS ₂	Ромбическая	<i>n</i>	5	1·10 ¹⁵	1.97	2.1	1·10 ⁴	30